



## DESAFIO 03

# Automação de dosagem de recheio a partir de pesagem do book de wafer

# Automação de dosagem de recheio a partir de pesagem do book de wafer



## PROBLEMA

Após a saída do forno, a cada hora, uma amostra da placa de wafer é coletada e pesada. Caso esteja acima do peso, o técnico irá definir ajustes nas etapas seguintes para evitar que o "book" (resultado final) esteja com sobrepeso.

Esse ajuste é definido de acordo com a expertise do técnico e é realizado na etapa de adição das camadas de recheio (com dosagem controlada digitalmente), para formar 4 camadas de wafer e 3 de recheio, e na prensa do book.

Os parâmetros alterados atualmente são:

- Temperatura do forno e volume da massa para formar a placa (vazão da bomba de injeção) na IHM do forno.
- Pressão da prensa de book.

## O QUE BUSCAMOS

**Sistema de análise e correção de parâmetros para otimização do peso do book, capaz de:**

- Receber os dados da pesagem das folhas de wafer (pesagem manual ou automatizada, dependendo da solução).
- Detectar a não-conformidade do peso.
- Gerar insights de correções nos parâmetros (opção 1).
- Atuar na correção inline dos parâmetros (opção 2)

## RESULTADOS ESPERADOS

- Reduzir variabilidade do peso do book e da placa.
- Melhorar o indicador CPM.

## REQUISITOS

- Integração com dados da balança.
- Integração com os PLC relacionados aos parâmetros modificados em caso de atuação inline.
- [Desejável] Enviar dados para o Infinity QS (sistema de gestão da qualidade).
- A arquitetura da solução deve estar de acordo com o padrão de arquitetura de rede industrial (Critical Control Network) da Mondelez: MINT.
- Os dados devem ser hospedados nos servidores locais.

## PoC SUGERIDA

- Foco em um dos fornos da linha modelo de wafer recheado.